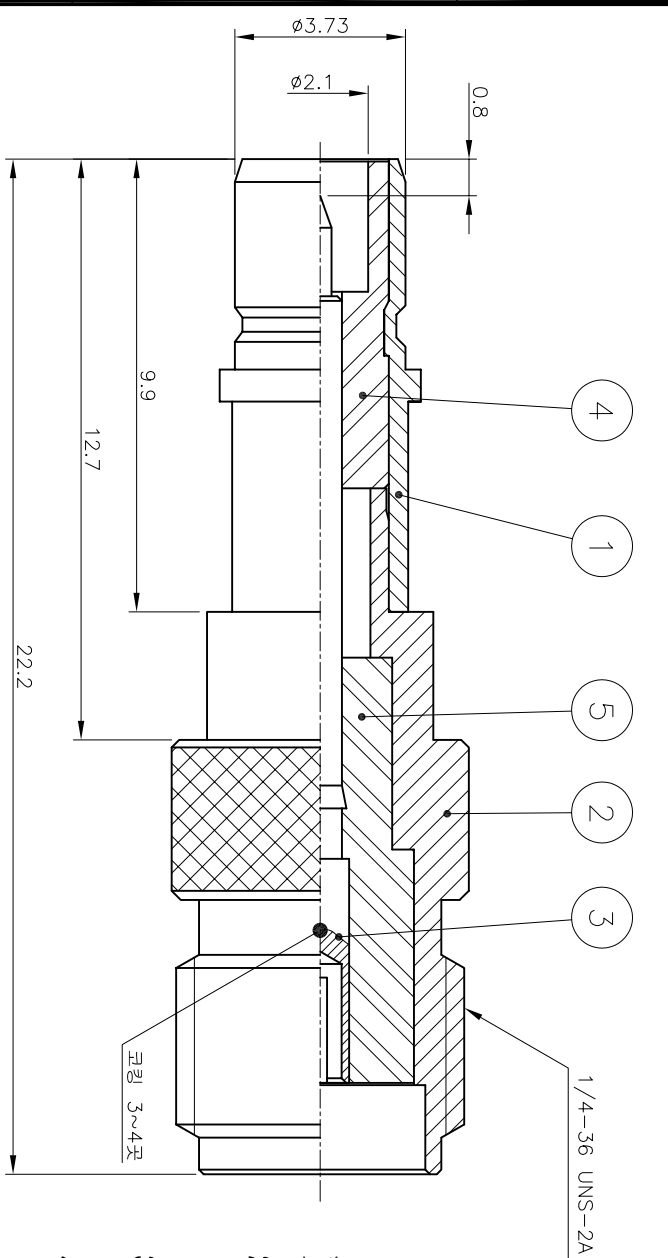
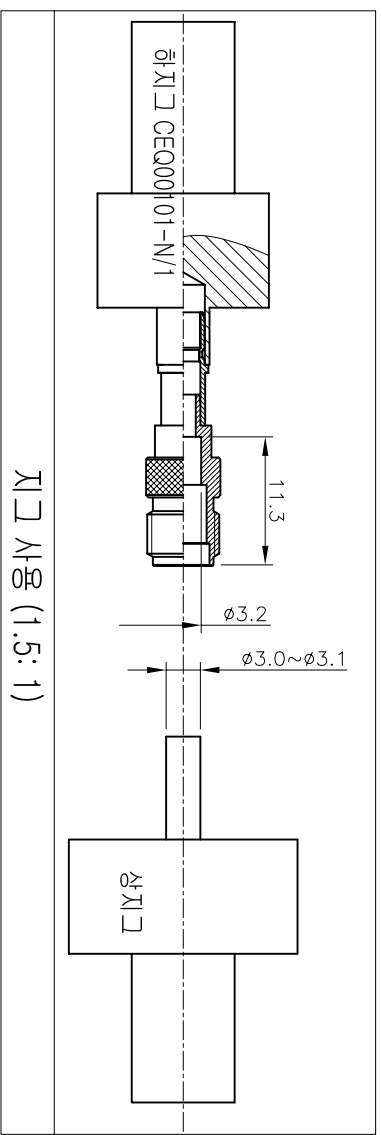


| REVISION |             |               | DATE |
|----------|-------------|---------------|------|
| REV      | DESCRIPTION |               |      |
| R        | 최초 개정       | 2009. 04. 24. |      |



- \* 조립 주기**
1. 1번 BODY와 6번 CAP을 위 도면을 참고 하여 끼운다.
  2. 위 조립 된 제품에 7번 SPRING을 끼운 후 2번 BODY를 삽입 후 1번 BODY와 억지끼움 한다. (관련 지그 사용 아래 도면 참조)
- \*\* 삽입 시 SPRING의 돌출을 주의 한다.**
3. 위 조립이 끝나면 SPRING에 의한 CAP이 좌우 움직이는지 확인 하고, 전장 치수를 확인 한다.
  4. 4번 INSULATOR 를 삽입한다. (TEFLON 내경  $\phi 2$  부 지그 사용)
  5. 5번 CONTACT를 삽입한다.
  5. 3번 CONTACT를 조립 후 코킹 작업을 한다.



지그 사용 (1.5: 1)

|                           |         |         |
|---------------------------|---------|---------|
| TOLERANCE                 | Decimal | ±0.1    |
|                           | Angle   | ±1°     |
| CHECKED BY I.C.KIM        |         |         |
| DRAWN BY E.H.KIM          |         |         |
| FINISH                    | -       |         |
| SCALE                     | 6/1     | UNIT mm |
| DATE 2009. 04. 24.        |         |         |
| APPROVED BY S.J.YOUN      |         |         |
| TITLE                     |         |         |
| SMB50TRANS-J-SMA50-J      |         |         |
| DWG NO. AD00402-7/2       |         |         |
| REVISION I R SHEET 1 of 1 |         |         |